

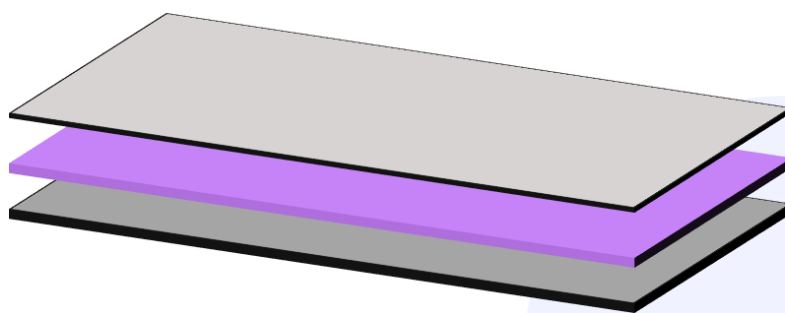
UV tape 產品介紹

Tel : +886-7-6217681

總公司：高雄市岡山區岡山北路二巷 51 號

應用(Application)

- 晶片研磨製程
- 晶片切割製程
- 晶片翻轉製程
- 陶瓷片切割製程
- 製品暫時固定



Release Film
UV Sensitive Adhesive
Base Film

特點(Feature)

- 半導體、電子與光電元件、LED 等產業晶圓晶片切割專用
- 品質特性經國際大廠驗證及使用、穩定性媲美日系產品
- 特殊黏膠配方，黏著力佳，抵抗切割晶片飛失
- 特殊結構設計，降低影響切割刀壽命
- 食品級包裝底材，無毒性，平整柔軟易頂取
- 照射紫外光(UV)後，黏度極低，不留殘膠
- 照射紫外光(UV)反應時間快速，有效提升工作效率



| 型號 Model | 使用製程 Process | 底材材質 Base film material | 顏色 Color | 特性 Characteristic |
|-------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------------------|
| E-22HA | 晶片/玻璃切割 (前段) | POF (Polyolefin) | 乳白色 | 利於挑撿 |
| E-26PA | | | | 抗側崩 |
| E-27EA | | | | 小晶粒切割 |
| VC-80A | | PVC (Poly vinyl chloride) | 藍色 | 優異的拉伸性質 |
| E-140A | 封裝後段切割 (後段) | POF (Polyolefin) | 乳白色 | 較少的切割殘屑 |
| E-150A | | | | 較少的殘膠 |
| E-180A | | | | 對印字影響小 |
| E-22ZH | | | | 優良的解膠性 |
| E-288A | | | | |

依您的需求，設計最符合您的客製化材料

Customize your material

Located in Kaohsiung

